

(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

更正本

(19) 世界知识产权组织
国际局



(10) 国际公布号

WO 2025/124265 A9

(43) 国际公布日
2025 年 6 月 19 日 (19.06.2025)

- (51) 国际专利分类号: **H01L 21/67** (2006.01) **H01J 37/32** (2006.01) 大兴区北京经济技术开发区文昌大道8号 100176 (CN)。
- (21) 国际申请号: PCT/CN2024/136985 (72) 发明人: 刘东旭(LIU, Dongxu); 中国北京市大兴区北京经济技术开发区文昌大道8号 100176 (CN)。王广永(WANG, Guangyong); 中国北京市大兴区北京经济技术开发区文昌大道8号 100176 (CN)。
- (22) 国际申请日: 2024 年 12 月 5 日 (05.12.2024)
- (25) 申请语言: 中文
- (26) 公布语言: 中文
- (30) 优先权: 202311737419.0 2023年12月15日 (15.12.2023) CN (74) 代理人: 北京天昊联合知识产权代理有限公司(TEE & HOWE INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS); 中国北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城西一办公楼5层1, 6-12室 100738 (CN)。
- (71) 申请人: 北京北方华创微电子装备有限公司(BEIJING NAURA MICROELECTRONICS EQUIPMENT CO., LTD.) [CN/CN]; 中国北京市 (81) 指定国(除另有指明, 要求每一种可提供的国家保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU,

(54) Title: COVER DEVICE, PROCESS CHAMBER AND SEMICONDUCTOR PROCESS APPARATUS

(54) 发明名称: 盖体装置、工艺腔室及半导体工艺设备

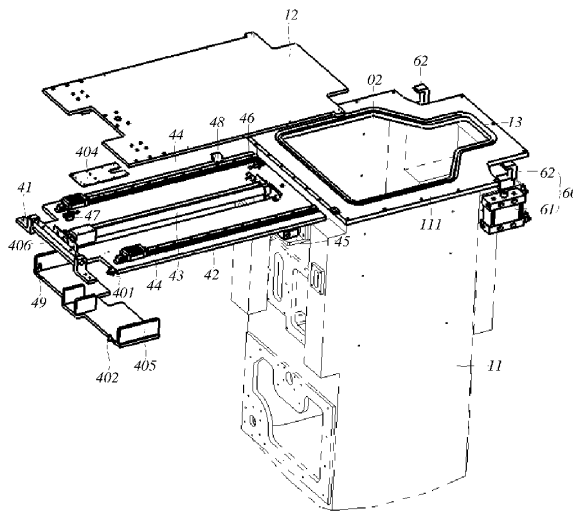


图 2

(57) Abstract: Disclosed in the present application are a cover device, a process chamber and a semiconductor process apparatus. The cover device comprises a cover, a connection seat and a cover seat; a first end of the cover seat is rotationally connected to the connection seat; the cover seat has a first state and a second state; a second end of the cover seat can rotate around the first end of the cover seat, so as to switch the cover seat between the first state and the second state; in the first state of the cover seat, the cover is inclined relative to a preset plane, and the cover is movable relative to the cover seat; in the second state of the cover seat, the cover is parallel to the preset plane. The described solution can solve the problem of inadequate sealing of process chambers in the prior art.

[见续页]

CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW。

(84) 指定国(除另有指明, 要求每一种可提供的地区保护): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

本国际公布:

— 包括国际检索报告(条约第21条(3))。

(48) 更正本的公布日:

2025 年 10 月 2 日 (02.10.2025)

(15) 更正内容:

见 2025 年 10 月 2 日 (02.10.2025) 公布的公告

(57) 摘要: 本申请公开一种盖体装置、工艺腔室及半导体工艺设备, 其中, 所公开的盖体装置包括盖体、连接座和盖体座, 所述盖体座的第一端转动地连接于所述连接座上, 所述盖体座具有第一状态和第二状态, 所述盖体座的第二端绕所述盖体座的第一端可转动, 以使所述盖体座在所述第一状态与所述第二状态之间切换; 在所述盖体座的第一状态, 所述盖体相对于预设平面倾斜, 并且所述盖体相对于所述盖体座可移动; 在所述盖体座的第二状态, 所述盖体与所述预设平面平行。上述方案能解决相关技术涉及的工艺腔室存在密封不严的问题。